

Toshiba va exposer une gamme de nouveaux produits et de nouvelles technologies à Embedded World 2019

Démonstrations de connectivité automobile Ethernet Gigabits et de nouvelles solutions de commande moteur dans le hall 3A, stand 424

Düsseldorf, Allemagne, 7 février 2019 - Toshiba Electronics Europe (TEE) a annoncé aujourd'hui sa participation au salon Embedded World 2019. La société va présenter une large gamme de nouveaux produits et de solutions technologiques exceptionnelles telles qu'un pont Ethernet Gigabits pour l'automobile avec prise en charge AVB (Audio Video Bridging, ou pont audio-video) / TSN (Time Sensitive Network, ou réseau à timing critique), de nouvelles solutions de commande de moteurs pas-à-pas, et aussi une solution très compétitive pour réduire le "time-to-market" (délai de commercialisation) et les coûts de conception d'ASIC (circuits spécifiques).

A l'heure où le marché automobile évolue vers des réseaux plus rapides, les visiteurs pourront évaluer le TC9562XBG, un pont Ethernet AVB / TSN . Le dispositif prend en charge les contraintes réseau temps-réel des véhicules et des systèmes ADAS (Advanced Driver Assist System, ou système avancé d'aide à la conduite) connectés d'aujourd'hui, qui nécessitent des débits pouvant atteindre 1 Gbits/s. Outre la conformité à la spécification Ethernet AVB, il répond également à la norme TSN, ce qui en fait aussi un bon candidat pour le marché industriel. Afin de pouvoir prendre en charge un large éventail de couches physiques et de commutateurs Ethernet, le TC9562XBG gère les interfaces MII, RMII, RGMII, et aussi SGMII.

Le TB67S128FTG est un driver de moteur pas-à-pas, qui permet de réaliser des économies d'énergie, tout en assurant une commande précise. Ce dispositif gère les micro-pas (1/128 de pas), ce qui en fait un candidat parfait pour des applications aussi diverses que les imprimantes 3D, les distributeurs automatiques de billets, et autres appareils ménagers, tout en réduisant le bruit généré par le moteur en cours de fonctionnement. La technologie AGC (Active Gain Control, ou contrôle de gain automatique) de Toshiba optimise le courant de pilotage en fonction du couple dont le moteur a besoin, ce qui évite le blocage et permet de réaliser des économies d'énergie. Le courant de pilotage élevé (50V / 5A) permet de fournir le couple nécessaire, tandis que la faible résistance à l'état passant (0.25 Ω) réduit au maximum l'échauffement.

Des ingénieurs seront également là pour offrir support et conseils aux visiteurs souhaitant utiliser le processus de fabrication FFSA™ (Fit Fast Structured Array) 130 nm récemment annoncé. Avant tout destiné aux applications industrielles, le nouveau procédé 130 nm FFSA™ rejoint les autres procédés Toshiba 28, 40 et 65 nm, et offre ainsi une option supplémentaire pour les équipements industriels. Le processus 130 nm propose différentes tranches maîtresses avec jusqu'à 664 kbits de RAM et environ 912.000 portes par dispositif.

Embedded World 2019 se tiendra du 26 au 28 février 2019 à Nuremberg, en Allemagne, et Toshiba* sera présent dans le Hall 3A, sur le stand 424, où son équipe technique sera disponible pour discuter des nouveaux produits et des produits existants, et aussi répondre aux questions techniques.

###

Note aux rédacteurs :

*Embedded world 2019 : Toshiba Electronics Europe co-expose avec Toshiba Memory Europe.

A propos de Toshiba Electronics Europe

[Toshiba Electronics Europe](#) (TEE) est la division européenne de composants électroniques de [Toshiba Electronic Devices and Storage Corporation](#). TEE offre aux consommateurs et aux entreprises européennes un large choix de disques durs (HDD) et de semiconducteurs innovants pour les applications automobiles, industrielles, IoT (Internet of Things, ou Internet des objets), de contrôle d'axe, de télécommunications, de réseaux, de grand-public ou d'électro-ménager. Le large catalogue de la société comprend des CI sans-fil, des semiconducteurs de puissance, des microcontrôleurs, des semiconducteurs optiques, des ASIC (circuits intégrés spécifiques), des ASSP et des dispositifs discrets allant de diodes à des CI logiques.

TEE a son siège à Düsseldorf en Allemagne, et possède des filiales en France, en Italie, en Espagne, en Suède et au Royaume-Uni, assurant la conception, la fabrication, le marketing et les ventes. Le président de la société est M. Tomoaki Kumagai.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Toshiba Electronics Europe www.toshiba.semicon-storage.com.

Personne à contacter pour les questions concernant la publication :

Toshiba Electronics Europe GmbH, Hansaallee 181, D-40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél : +49 (0) 211 5296 0 Fax : +49 (0) 211 5296 79197

Web: www.toshiba.semicon-storage.com/eu/company/news.html

Courriel : discrete-ic@toshiba-components.com

Pour des informations concernant la publication, contactez :

Michelle Shrimpton, Toshiba Electronics Europe

Tél : +44 (0)193 282 2832

E-mail : MShrimpton@teu.toshiba.de

Publié par :

Birgit Schöniger, Publitek

Tél : +44 (0)20 84296554

Web : www.publitek.com

E-mail : birgit.schoeniger@publitek.com